

[作者投稿系统](#)[编辑办公系统](#)[编委审阅系统](#)[专家审稿系统](#)[在线投稿注意事项](#)[投稿须知](#)[返回起始页>>](#)[全文检索](#)

LTCC小型化Balun设计

作者：厉强¹，杨涛²，金龙¹，尉旭波¹

关键词：巴伦；耦合线；低温共烧陶瓷；多层电路

摘要

介绍了一种基于LTCC(低温共烧陶瓷)技术的小型化balun的设计。设计的Balun采用Marchand balun结构，使用LTCC技术实现多层结构、上下耦合的方式减小balun的体积并拓展带宽。该balun工作在1.7~2.2 GHz，体积为2.8 mm×3 mm×1 mm，并且平衡端口输出具有良好的幅值平衡和180°相位差。

请点击下载（右键另存为）或浏览:UESTC20080724.pdf